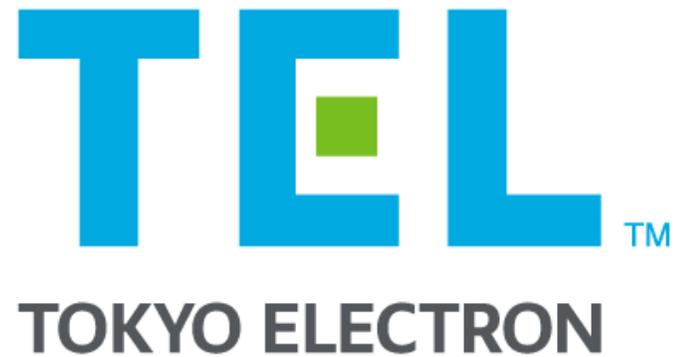


第55期 定時株主総会



2018年6月19日

第55期 業績報告

連結損益計算書

	第54期		第55期		増減	(億円)
		(%)		(%)		
売上高	7,997	100.0	11,307	100.0	+3,310	
SPE	7,498	93.8	10,552	93.3	+3,053	
FPD	493	6.2	750	6.7	+256	
その他	4	0.0	4	0.0	△0	

SPE: 半導体製造装置

FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

連結売上は市場成長率を超えた前期比+41%の増収、初の1兆円越え

連結損益計算書

	第54期		第55期		増減	(億円)
		(%)		(%)		
売上高	7,997	100.0	11,307	100.0	+3,310	
売上総利益	3,222	40.3	4,750	42.0	+1,527	
営業利益	1,556	19.5	2,811	24.9	+1,254	
経常利益	1,575	19.7	2,807	24.8	+1,231	
特別利益	0		0		+0	
特別損失	84		55		△29	
税引前利益	1,491	18.6	2,752	24.3	+1,261	
親会社株主に帰属する当期純利益	1,152	14.4	2,043	18.1	+891	

売上高、各利益はいずれも過去最高

2018年3月期ハイライト

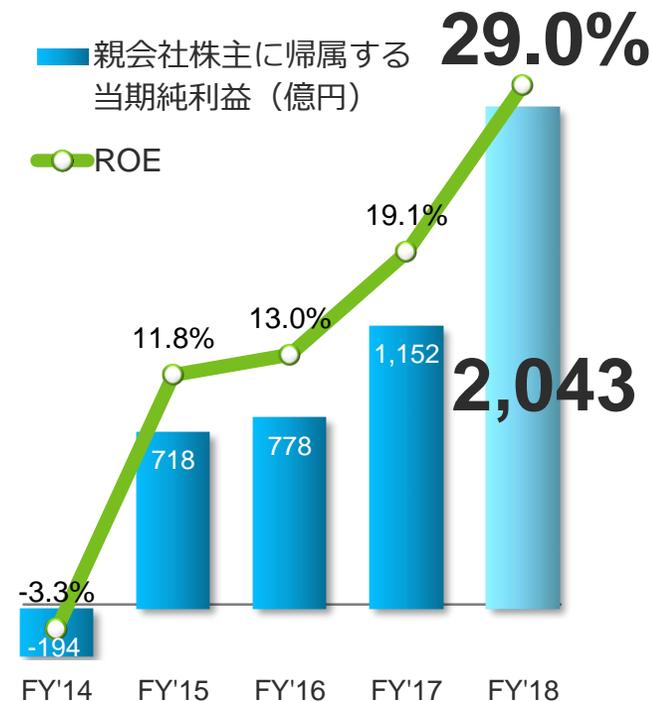
売上高と売上総利益率



営業利益と営業利益率



親会社株主に帰属する 当期純利益とROE



売上高、利益額に加えて、利益率も大きく向上

成長の要因

	FY'18 (対FY'17)
WFE市場成長 (注) WFE市場成長率はCYベースの数字	+37%
当社売上高成長	+41%
当社営業利益伸び率	+81%



洗淨装置



エッチング装置



ALD*装置

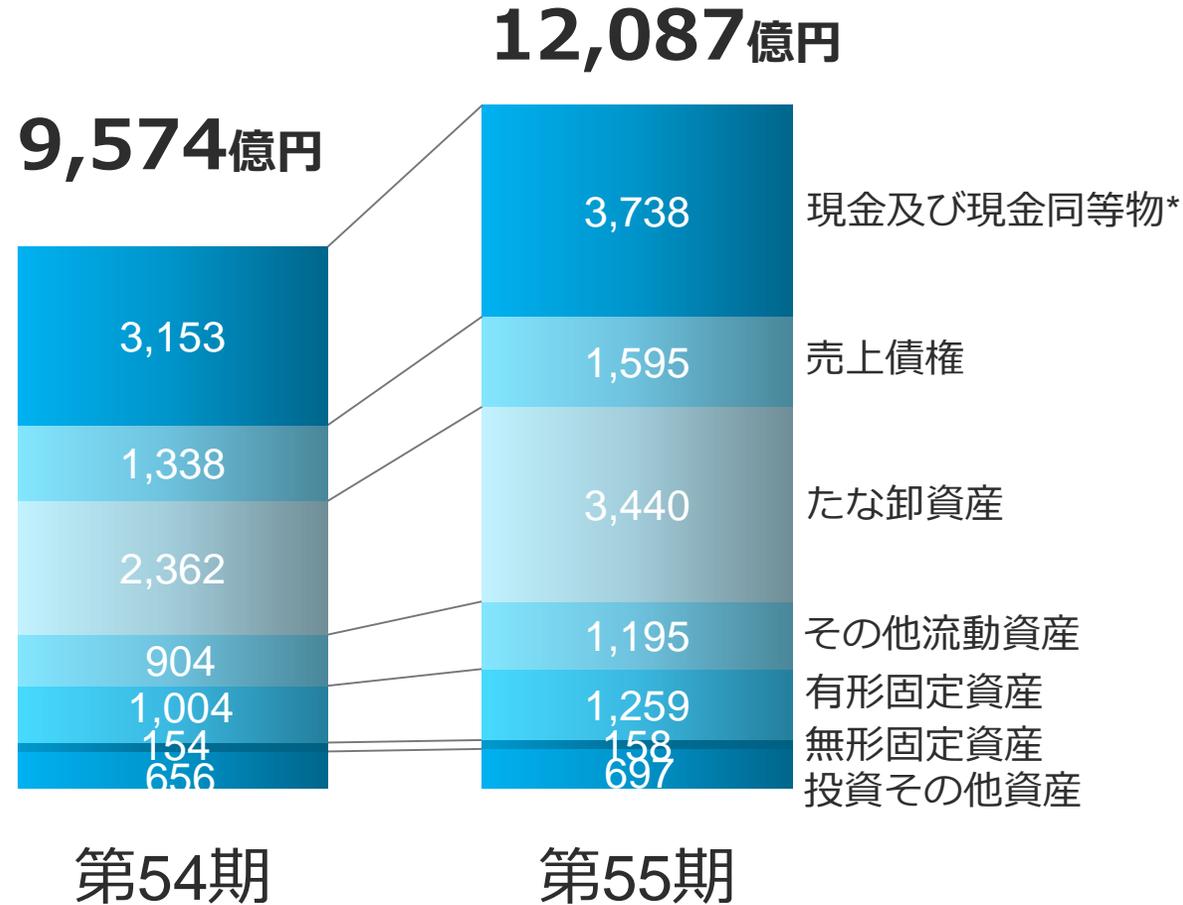
WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体前工程製造装置

*ALD: 原子層堆積

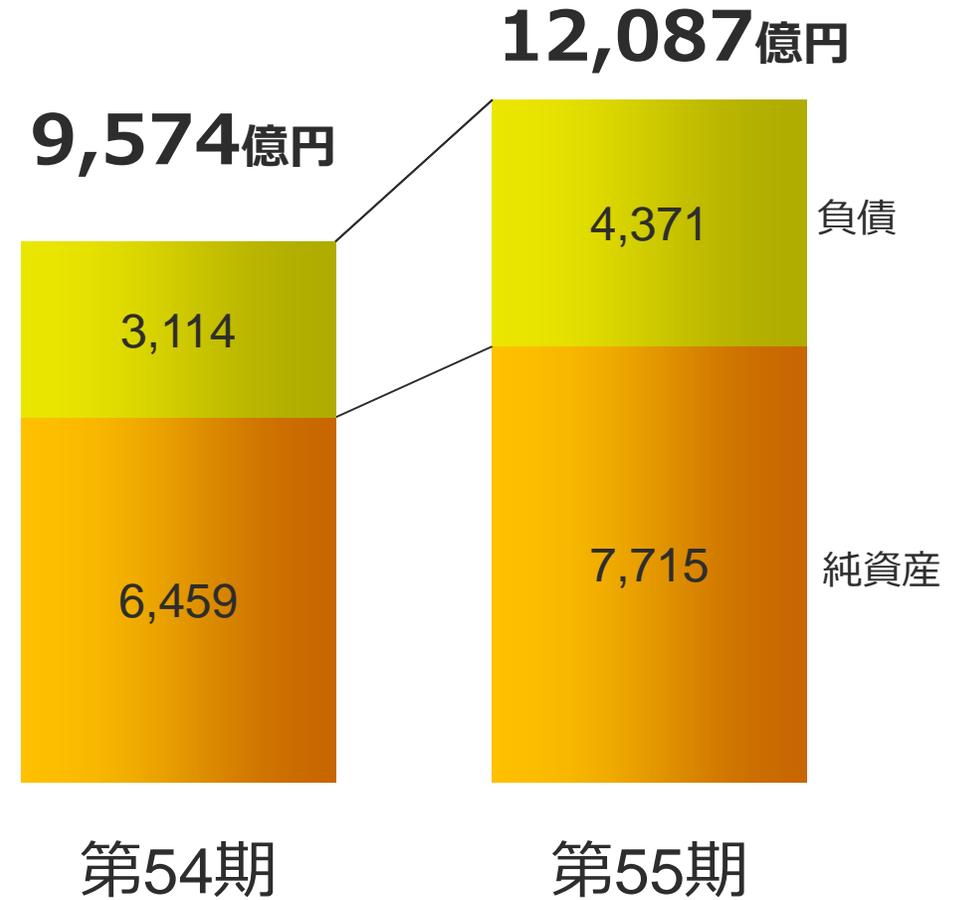
成長分野への参入、そこでのシェア拡大で 市場成長を超える成長を達成

連結貸借対照表

資産



負債・純資産



*定期預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）を含む

単独財務諸表の概要

■ 損益計算書

	第54期 (%)		第55期 (%)		増減
売上高	7,510	100.0	10,527	100.0	+3,016
営業利益	605	8.1	1,228	11.7	+622
経常利益	618	8.2	1,285	12.2	+666
税引前利益	638	8.5	1,272	12.1	+634
当期純利益	466	6.2	913	8.7	+446

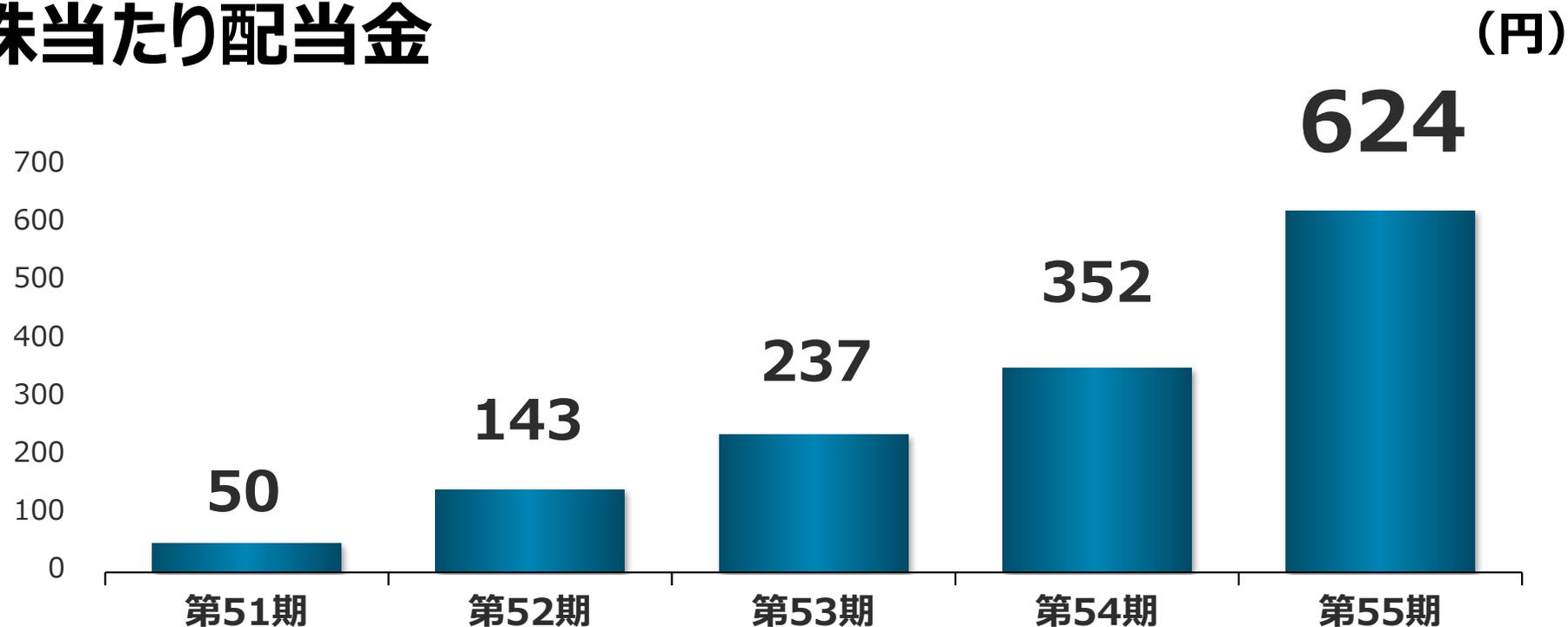
(億円)

■ 貸借対照表

	第54期 (%)		第55期 (%)		増減
資産合計	7,686	100.0	9,940	100.0	+2,254
負債合計	4,281	55.7	6,361	64.0	+2,079
純資産合計	3,405	44.3	3,579	36.0	+174
負債・純資産合計	7,686	100.0	9,940	100.0	+2,254

第55期配当

▶ 1株当たり配当金



	中間	期末	年間
第55期	277	347	624

配当総額	連結配当性向
1,023億円	50.1%

第56期 業績見通し

事業環境

■ 半導体設備(SPE)投資

半導体前工程の設備投資額は、旺盛なメモリ向け需要に牽引され、前年比15%程度の成長を予想

■ フラットパネルディスプレイ(FPD)設備投資

FPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資で調整があるものの、大型パネル向け設備投資が需要増加により大きく拡大し、前年比10%程度の成長を予想

第56期 連結業績見通し

	上期	下期	通期	前期比
売上高	6,900	7,100	14,000	+23.8%
SPE	6,340	6,540	12,880	+22.1%
FPD	560	560	1,120	+49.2%
営業利益	1,730 25.1%	1,930 27.2%	3,660 26.1%	+30.2% +1.2pts
経常利益	1,730	1,930	3,660	+30.4%
税引前利益	1,730	1,930	3,660	+33.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,280	1,420	2,700	+32.1%

(億円)

SPE: 半導体製造装置 FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

**市場成長以上の売上拡大、
3期連続の最高益*更新を見込む**

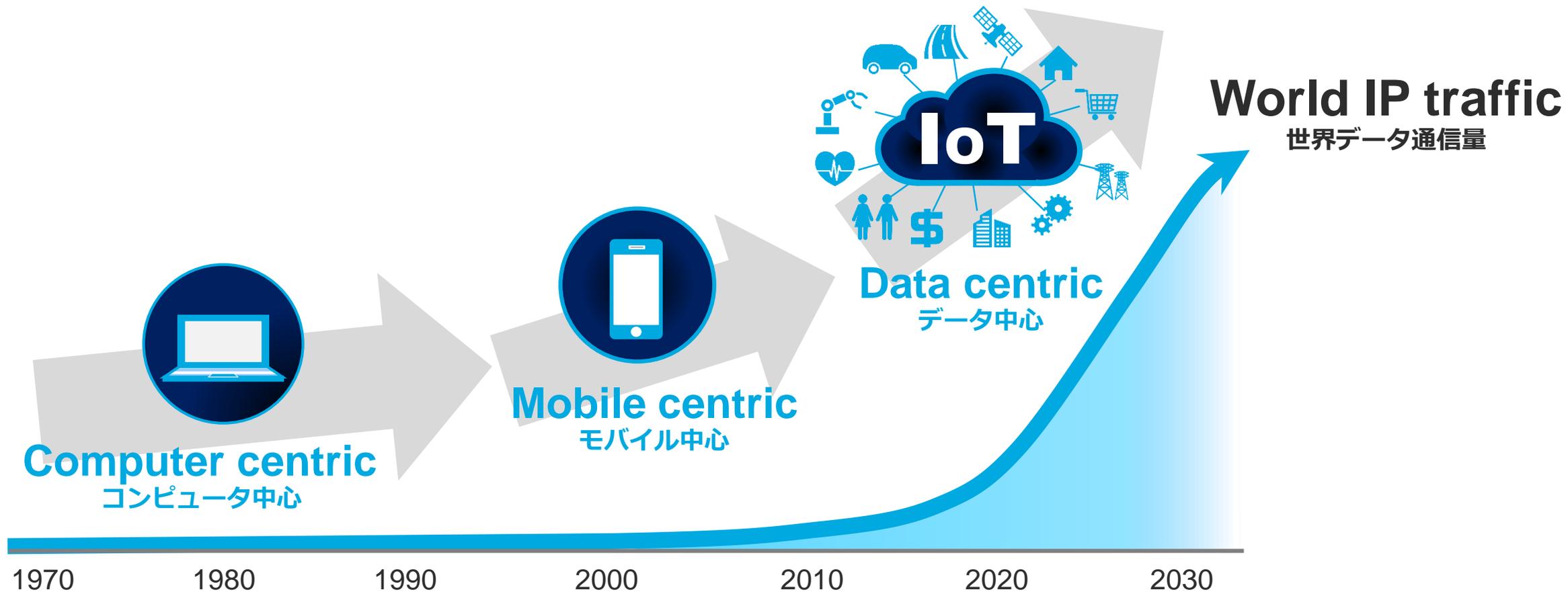
*親会社株主に帰属する当期純利益

さらなる成長を目指して

1. 事業環境と当社のビジネス
2. 新財務モデル
3. 社会の持続的な発展に向けて
4. 株主様への還元

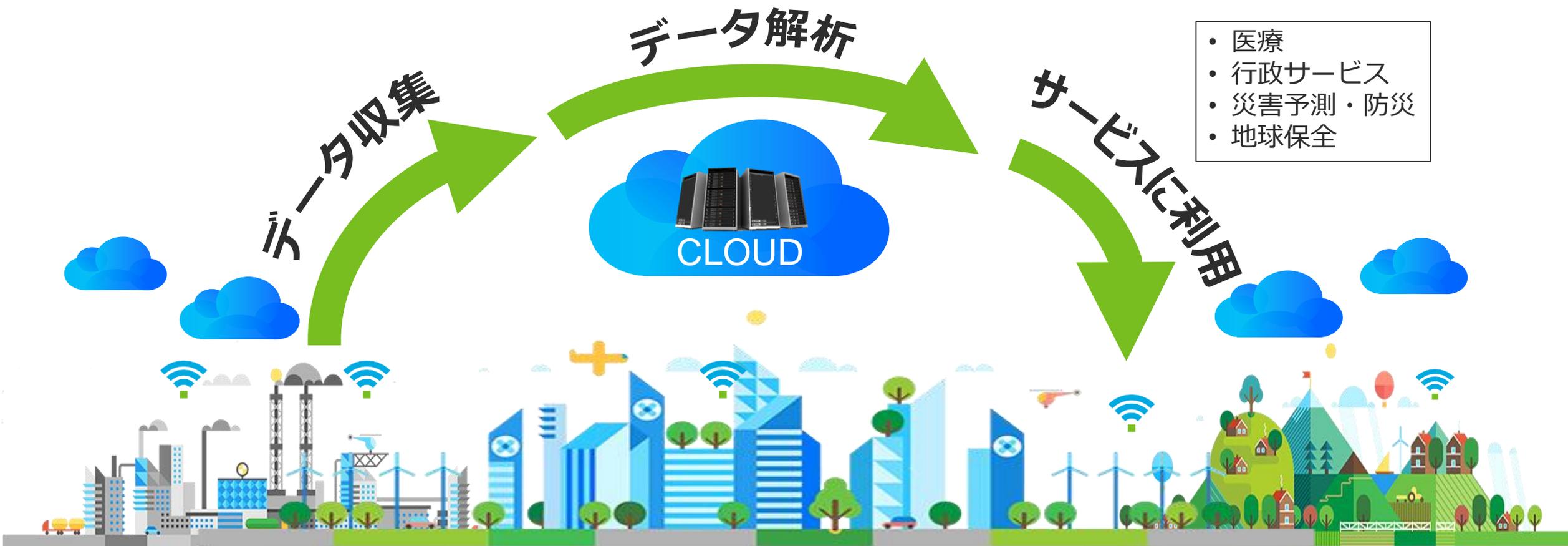
事業環境と当社のビジネス

今、時代の変化点にいる我々



IoT技術の普及でビッグデータ時代が始まる

ビッグデータは宝の山



データで社会が豊かになろうとしている

ビッグデータが実現するアプリケーション/サービス

スマートモビリティ



遠隔医療



スマートシティ



スマートグリッド



IoT 5G CLOUD AI
VR/AR/MR

自動運転



スマートファブ



産業ロボット



半導体のさらなる技術進化が求められる

クラウドに大きな投資

ハイパースケールデータセンター^{*1}が 建設ラッシュ

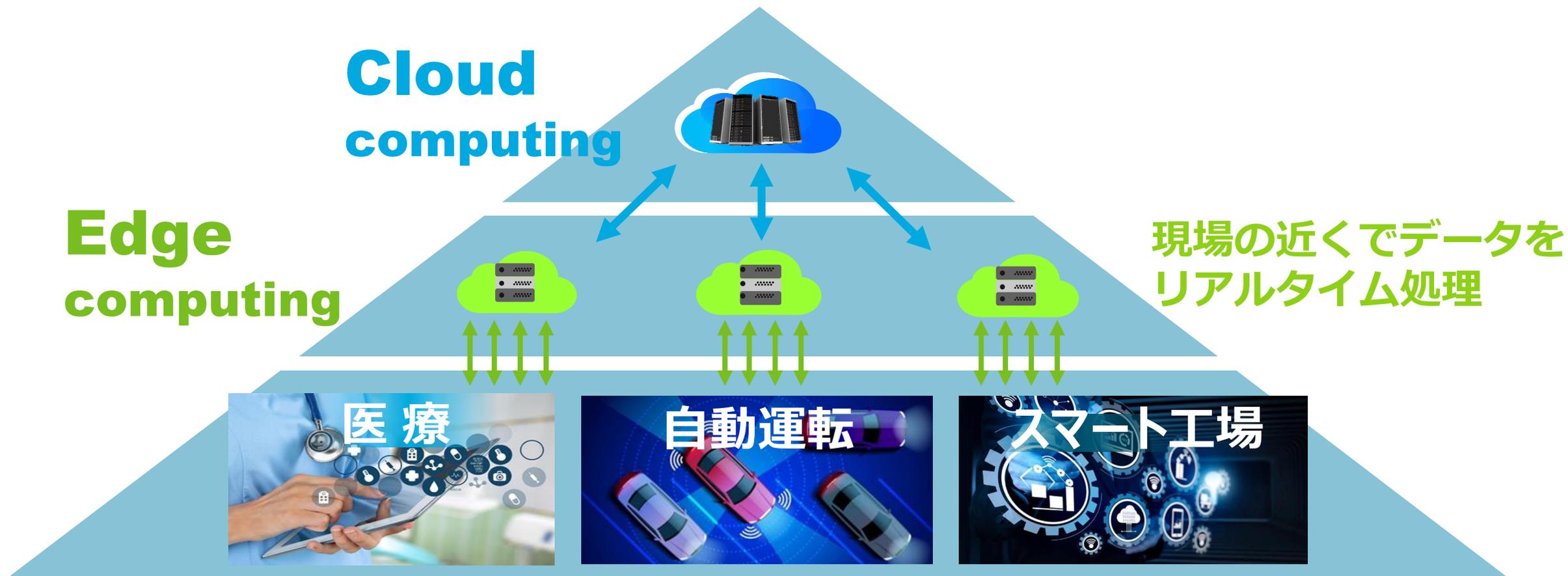
338 → 628 拠点
2016年 2021年 出所: CISCO

- データ拡大継続 (CAGR27%^{*2})
- 主体であるサーバは5年毎に入替が必要

*1: CISCOの定義 : IaaS/PaaSで10億ドル超、SaaSで20億ドル超、インターネット/検索/SNSで40億ドル超、e-コマース/決済処理で80億ドル超の収益要件を満たす業者
*2: Source: CISCO GCI2017.2 2016-2021のデータセンタートラフィックのCAGR

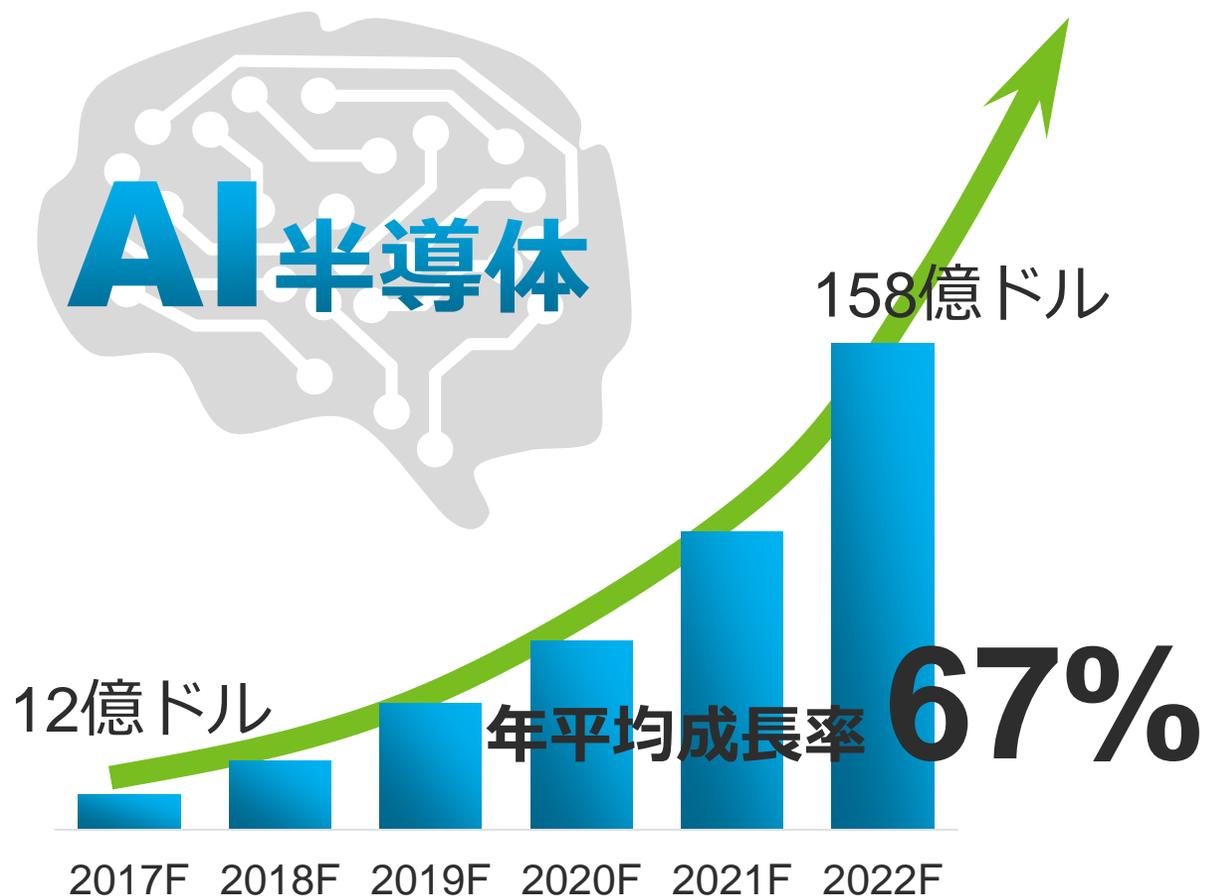
旺盛なメモリ需要が継続

新潮流 エッジコンピューティング



遅延が許されないサービス向けに今後市場拡大
高速、省エネの最先端チップが不可欠

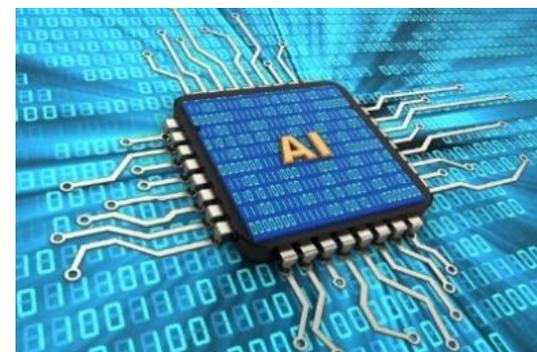
人工知能 AI



Source: Gartner Forecast : AI Neural Network Processing Semiconductor Revenue, Worldwide, 2018, issued on 11 January 2018
図はガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成

驚異的な勢いで普及するAI

AI半導体の開発競争も激化



Data-driven societyが 半導体産業の成長をけん引

Data-driven society: データ社会

IoT/ビッグデータ時代の半導体

大容量

低消費
電力

高速

高信頼性

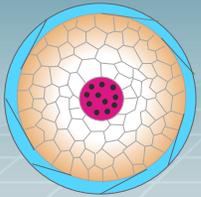


大量で多様、さらなる高度化が必要

驚くべき半導体の微細化レベル

10,000分の1

0.1ミリメートル



髪の毛の
直径

6~8ミクロン



赤血球

100ナノメートル



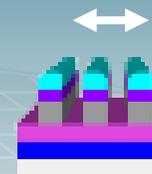
煙の粒子

14ナノメートル



最小ウィルス

10ナノメートル
以下



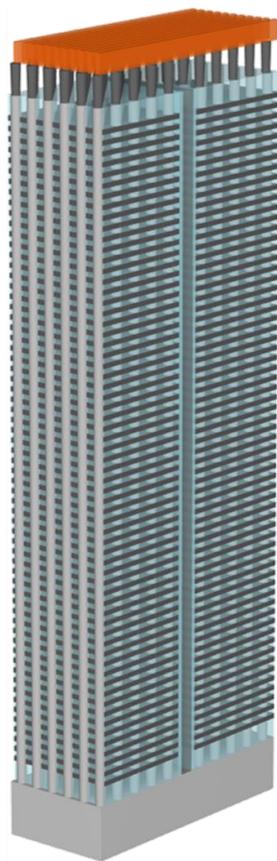
半導体の
加工寸法

半導体技術は究極のナノエレクトロニクスへ

3D NANDメモリの加工技術

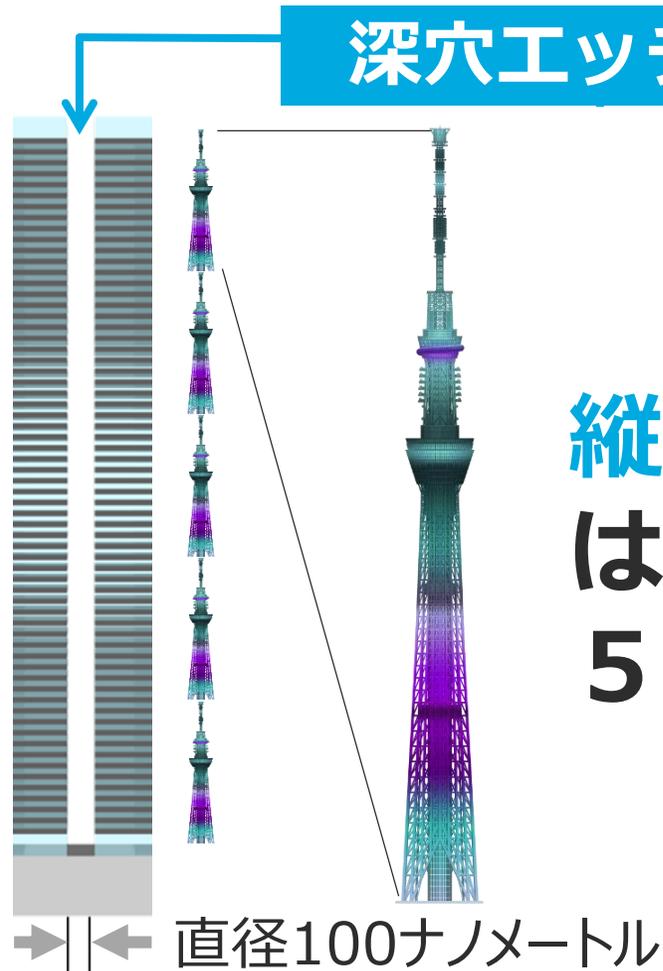
3D NANDメモリのセル構造

64層



4~5ミクロン

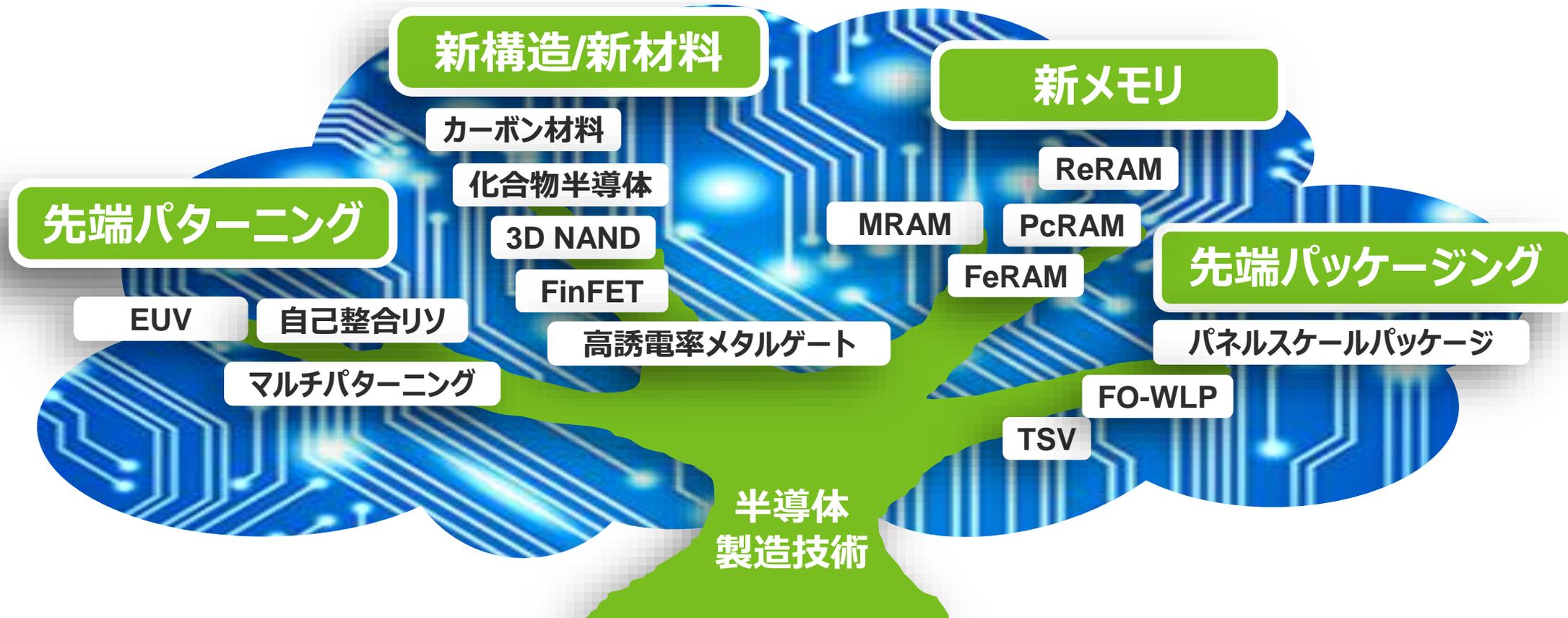
深穴エッチング加工



縦横比(50 : 1)
はスカイツリー
5本分に相当

求められる超微細加工技術

半導体の進化は止まらない



多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える

IoT時代、ディスプレイにも変化が起こる



ディスプレイの用途が拡大

ディスプレイの技術トレンド

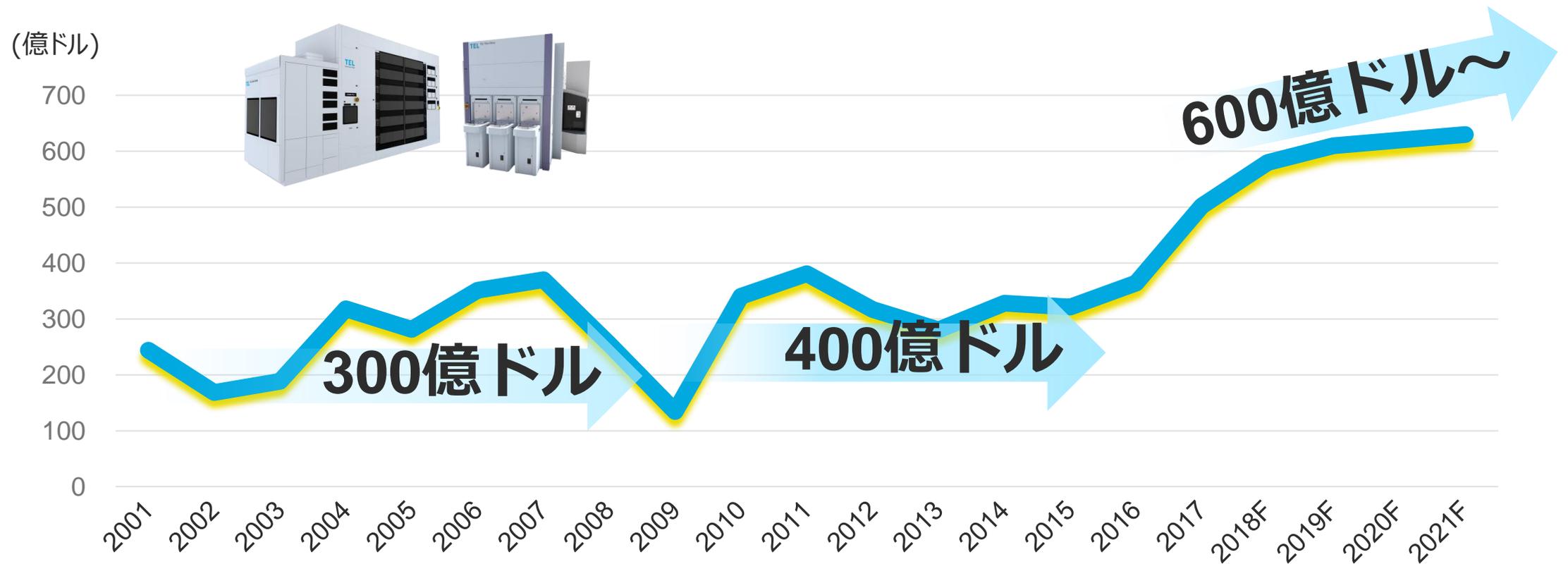


- サイズ拡大
- 高精細化
- 有機EL
- デザイン性 (フレキシブル、折れ曲がる、自由形状)

ディスプレイの技術進化も止まらない

技術革新が続く限り市場は拡大

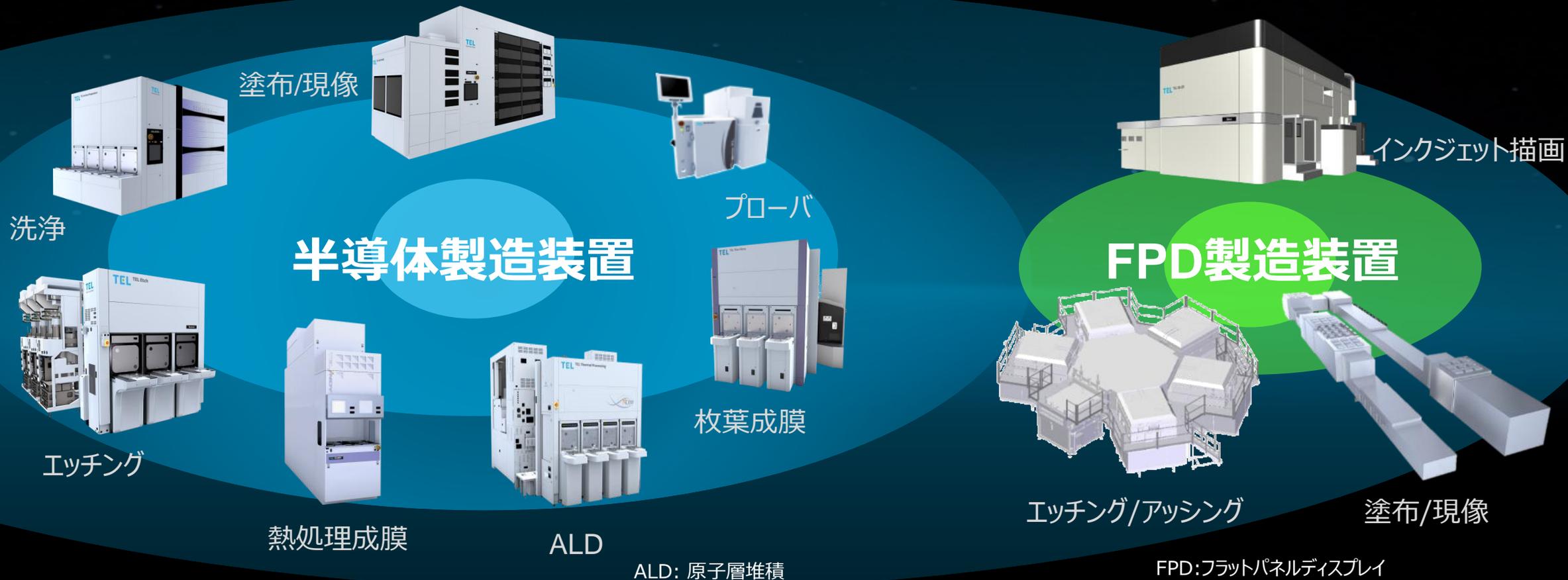
WFE (半導体前工程装置) 市場展望



Source: 2001~2017; SEAJ, SEMI, SEMIジャパン (Wafer Process +Test), 2018~2021; 当社推定

半導体前工程装置市場は一段上のフェーズへ

当社の製品ラインアップ



多様な製品群、豊富な技術で 技術革新を推進

**さらなる市場拡大と
当社の高い成長機会をベースに
財務モデルを改定**

新財務モデル

(旧) 中期経営計画の進捗

	FY'16 実績 53期	FY'17 実績 54期	FY'18 実績 55期	FY'19 予想 56期	(旧) FY'20 財務モデル 57期	
WFE* 市場規模	310億ドル	370億ドル	510億ドル	580億ドル	420億ドル	450億ドル
売上高	6,639億円	7,997億円	11,307億円	14,000億円	10,500億円	12,000億円
営業利益率	17.6%	19.5%	24.9%	26.1%	24%	26%
ROE (自己資本利益率)	13.0%	19.1%	29.0%	-	20~25%	

* WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体前工程製造装置

製品競争力の強化、収益性の向上、
とともに計画通り進む

新財務モデル（58期 FY2021）

WFE
市場規模

550億ドル
(6兆円*)

620億ドル
(6兆8千億円*)

売上高

1兆5000億円

1兆7000億円

営業利益率

26.5%

28%

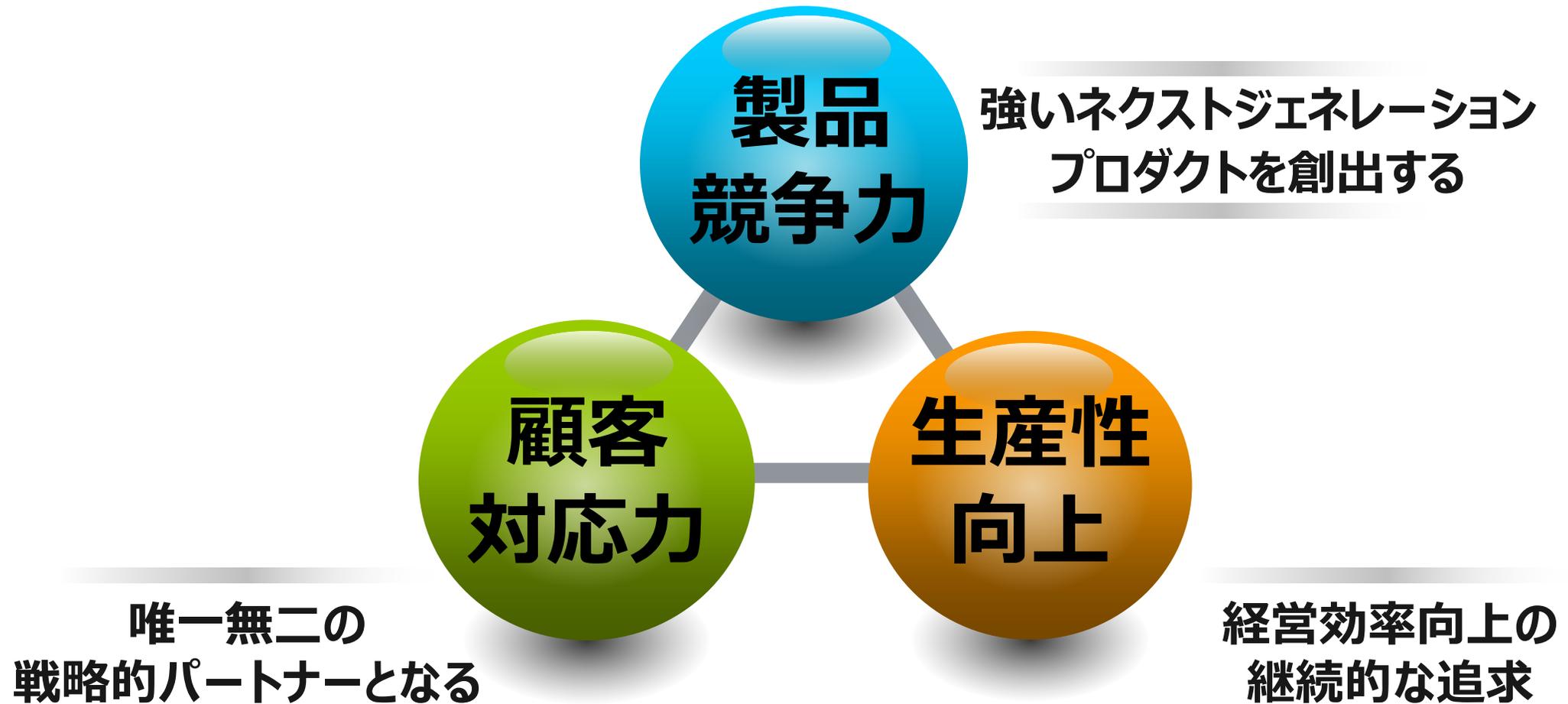
ROE（自己資本利益率）

30% ~ 35%

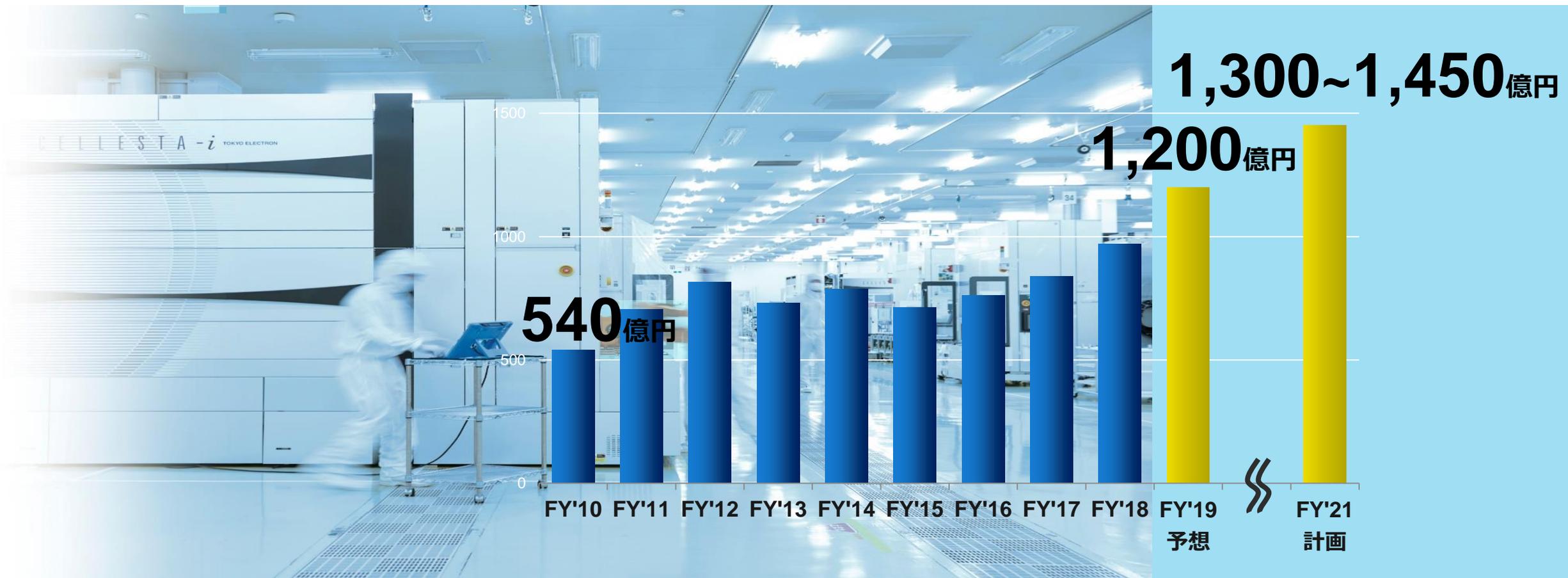
*換算レート110円/ドル

中長期的にワールドクラスの営業利益率
30%以上を目指す

新しい成長に向けた3つの強化項目



研究開発費



注力分野、将来技術に積極的な成長投資

開発・生産能力の増強

宮城工場

2018年9月
竣工予定

新開発棟

山梨工場

2020年4月
竣工予定

新生産棟

東北工場

2019年9月
竣工予定

新生産棟



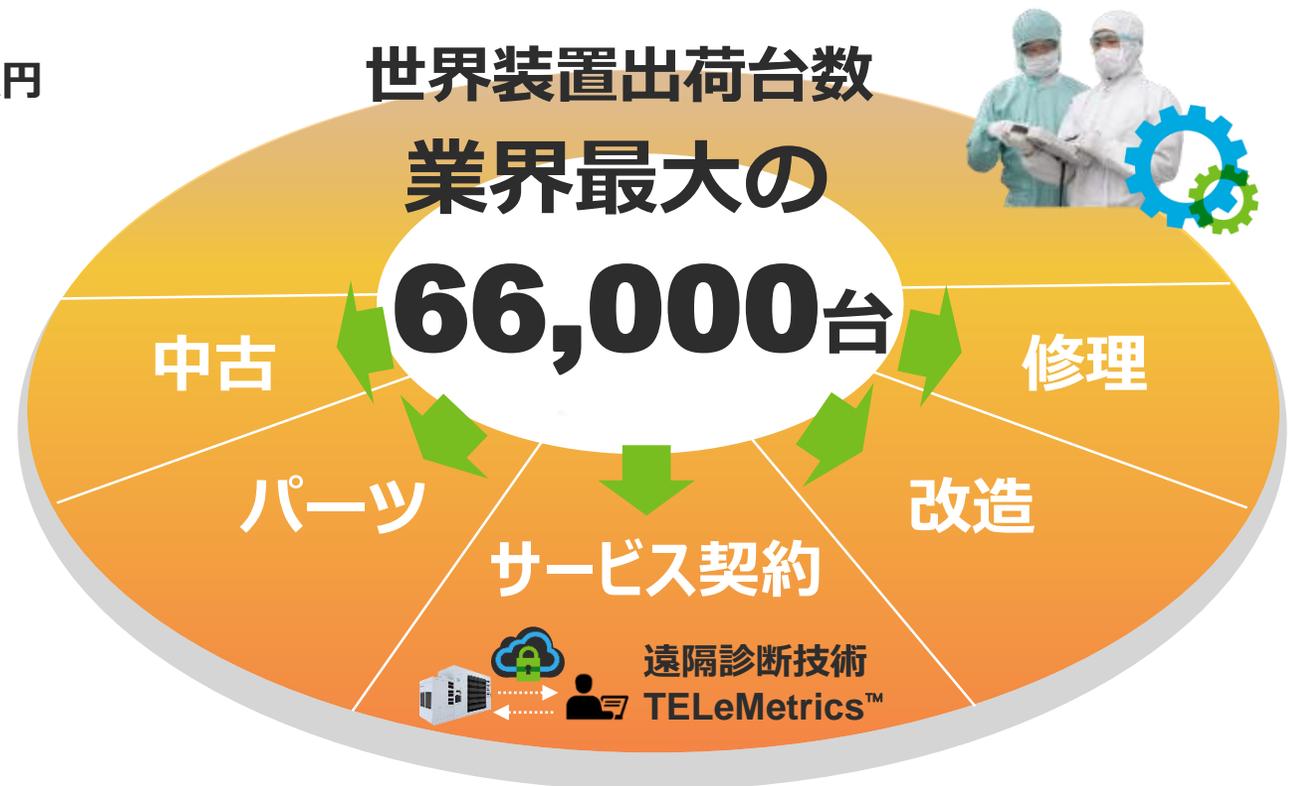
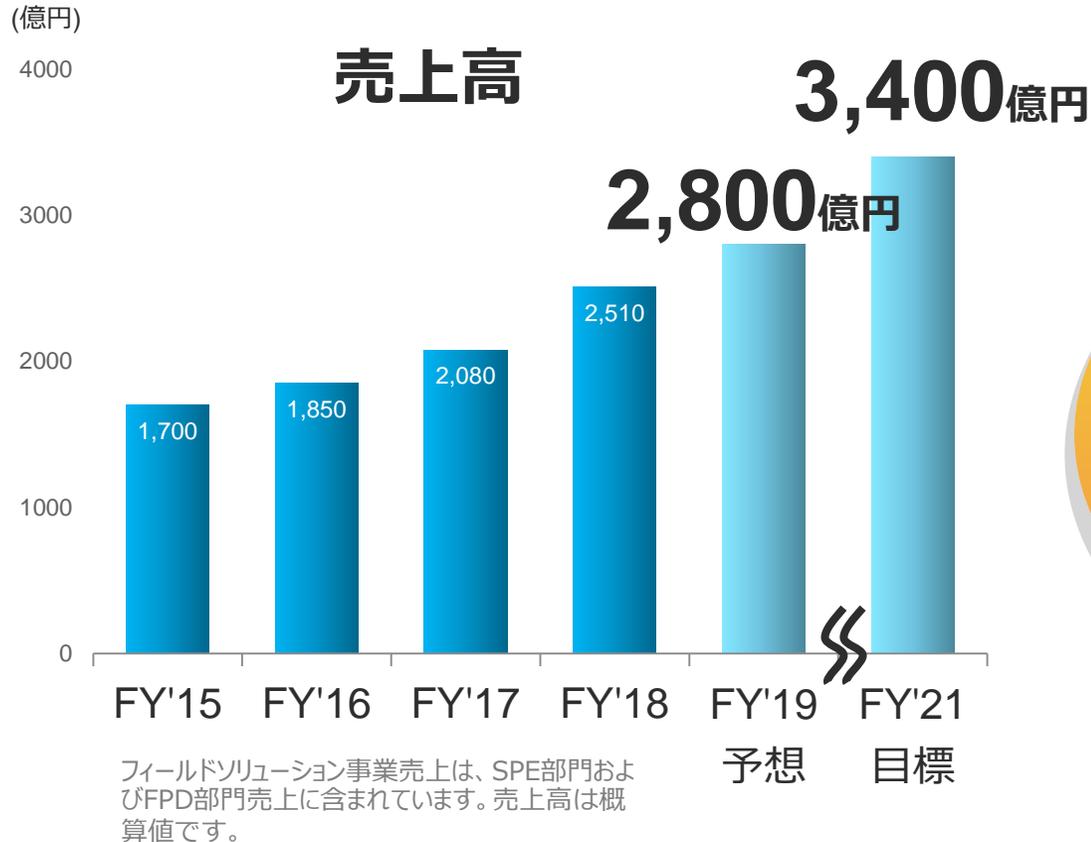
エッチング装置



成膜装置
ガスケミカルエッチング装置
テストシステム

エッチングと成膜、成長分野の開発/生産体制を拡充

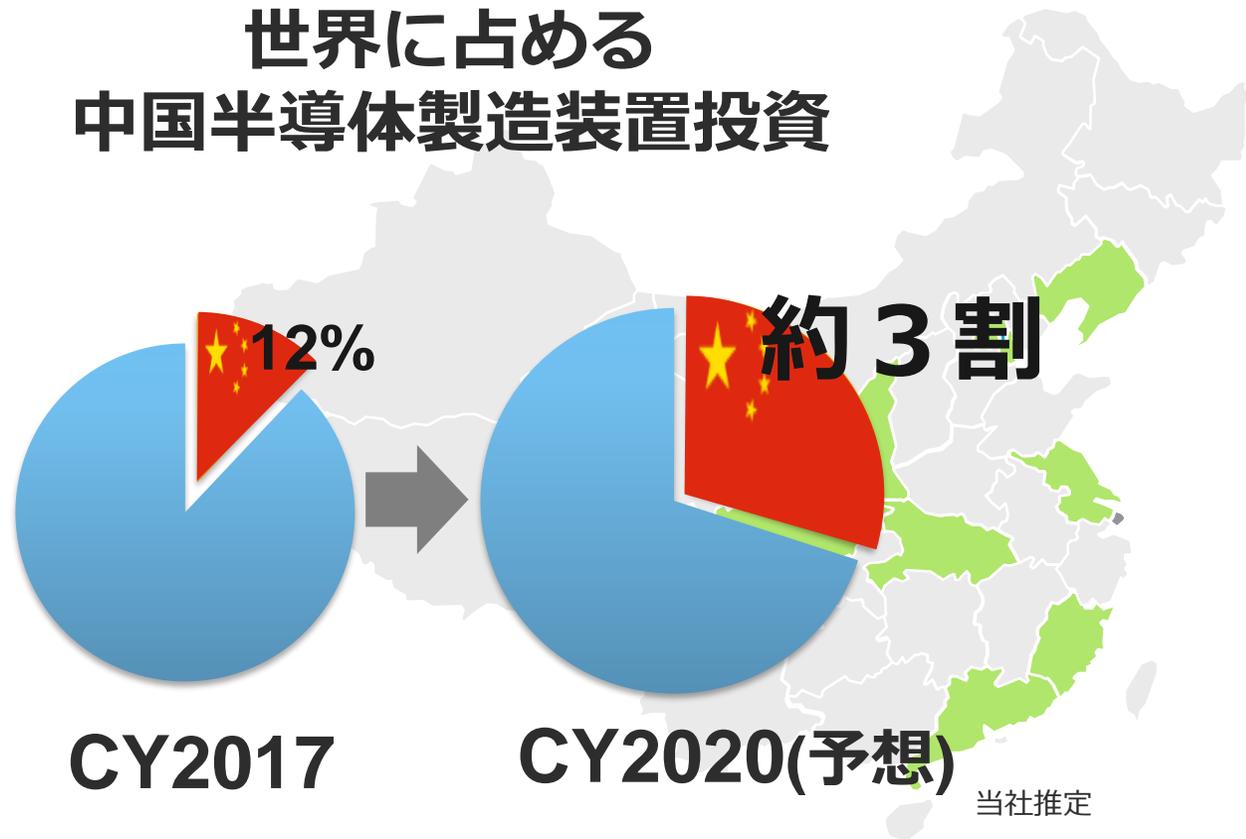
拡大するフィールドソリューション事業



販売した装置が新たな事業機会と価値を生む

中国での市場拡大に対応

世界に占める
中国半導体製造装置投資



TEL中国売上*



成長市場において、強固なビジネス基盤を構築

**究極の微細化技術、高い品質、
世界一のアフターサービス、
これらを展開するのがTEL**

社会の持続的な発展に向けて (ESG)

さらなる社会価値向上に向けて



ESGへの取り組み

E: 環境	気候変動、水、生物多様性、 環境マネジメント
S: 社会	人権、雇用・労働、健康安全、 サプライチェーン、地域社会
G: ガバナンス	コーポレートガバナンス、法令遵守、 リスクマネジメント

**全てのステークホルダーからの
信頼があってこそ企業は成長**

外部からの評価

当社株式が組み入れられているESG関連インデックス

MEMBER OF
**Dow Jones
Sustainability Indices**
In Collaboration with RobecoSAM



FTSE4Good

MSCI



2018 Constituent
MSCI ESG
Leaders Indexes

TELのESG（環境・社会・ガバナンス）への 取り組みに世界から高い評価

トムソン・ロイター社の
**Top 100 Global
Tech Leaders**
に選出される 2018年1月



地球環境への貢献

半導体のさらなる省電力化は IoT時代の大きな課題

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

世界を変えるための17の目標



東京エレクトロニクスはSDGsを支援しています

TELの技術提案で豊かな社会を創造する

**最先端の技術を提供する当社が
果たすべき 社会的な使命と責任は
未来に向けさらに高まる**

株主様への還元

還元に関する基本的な考え方

革新的技術力・独創的提案力で付加価値創出



利益の追求・企業価値の向上



ステークホルダーへの適切な還元

配当政策

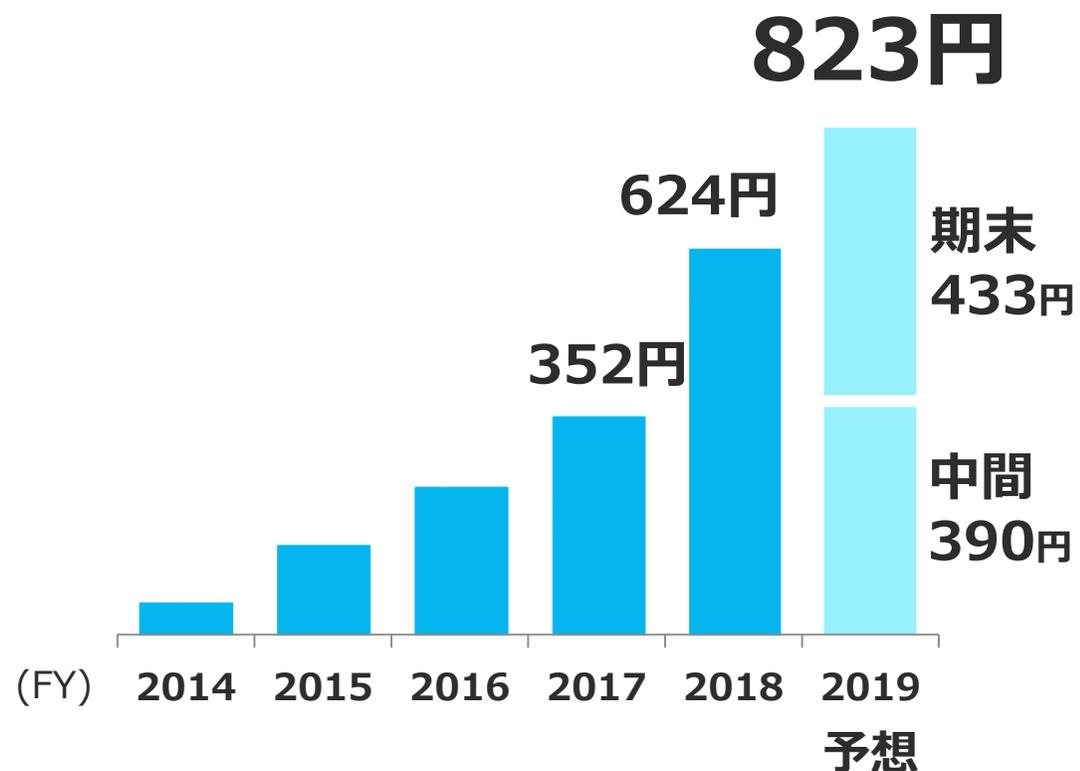
連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

配当金の推移

1 株当たり配当金



2019年3月期配当、
前期比30%以上の
増配を予定

決議事項

1. 取締役 1 2 名選任の件
2. 第 5 5 期取締役賞与金支給の件
3. 当社取締役に対し株式報酬として新株予約権を発行する件
4. 当社及び当社子会社の役員等に対し株式報酬として新株予約権を発行する件
5. 当社取締役に対し中期業績連動報酬として株式報酬制度を導入する件

第1号議案

取締役 12名選任の件

第1号議案 取締役12名選任の件

<取締役候補者氏名>

- | | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| 1. | <small>つねいし</small>
常石 | <small>てつお</small>
哲男 | 8. | <small>すのはら</small>
春原 | <small>きよし</small>
清 |
| 2. | <small>かわい</small>
河合 | <small>としき</small>
利樹 | 9. | <small>ひがし</small>
東 | <small>てつろう</small>
哲郎 |
| 3. | <small>きたやま</small>
北山 | <small>ひろふみ</small>
博文 | 10. | <small>いのうえ</small>
井上 | <small>ひろし</small>
弘 |
| 4. | <small>あきもと</small>
飽本 | <small>まさみ</small>
正巳 | 11. | チャールズ・デイトマース・
レイク二世 | |
| 5. | <small>ほり</small>
堀 | <small>てつろう</small>
哲郎 | 12. | <small>ささき</small>
佐々木 | <small>みちお</small>
道夫 |
| 6. | <small>ささき</small>
佐々木 | <small>さだお</small>
貞夫 | | | |
| 7. | <small>ながくぼ</small>
長久保 | <small>たつや</small>
達也 | | | |

注) 井上弘氏、チャールズ・デイトマース・レイク二世氏
及び佐々木道夫氏は、会社法第2条第15号に定める
社外取締役候補者であります。

第2号議案から第5号議案に関連して

	固定基本報酬	年次業績連動報酬		中期業績連動報酬
	月額報酬	現金賞与	株式報酬 ※ (ストックオプション)	株式報酬 (パフォーマンスシェア)
取締役 (社外取締役を除く)	第48期定時株主総会 において固定基本報酬 限度額をご承認いた だいております。	第2号議案	第3号議案	第5号議案
社外取締役		第2号議案	対象外	対象外
監査役		対象外	対象外	対象外

※ 第4号議案は、当社執行役員及び幹部社員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び幹部社員に対する株式報酬（ストックオプション）として新株予約権を発行することを目的として付議しております。

第2号議案

第5 5期取締役賞与金 支給の件

第2号議案 第55期取締役賞与金支給の件

第55期取締役賞与金	
対象者	第55期末日における取締役12名 (うち社外取締役2名)
報酬額	総額 19億8,000万円 (うち社外取締役分、3,800万円)

第3号議案

当社取締役に対し株式報酬として
新株予約権を発行する件

第3号議案 当社取締役に対し株式報酬として 新株予約権を発行する件

取締役に対する株式報酬（ストックオプション）	
対象者	本総会で選任される当社取締役 （社外取締役を除く） ※対象者は9名
報酬総額	総額 18億1,900万円の範囲内

第3号議案 当社取締役に対し株式報酬として 新株予約権を発行する件

取締役に対する株式報酬（ストックオプション）の内容

新株予約権の総数	新株予約権数 980個（上限） 当社普通株式 98,000株（上限）
新株予約権の発行価額	無償
1株当たりの払込金額	1円
権利行使期間	3年間の権利行使制限期間を設定、 行使期間は新株予約権の割当日から3年を経過する日の翌月1日から、 新株予約権の割当日から20年を経過する日の前月末日までとする
行使条件	① 新株予約権1個を最低行使単位とする ② その他の権利行使の条件は、お手元の招集ご通知をご参照ください

第4号議案

当社及び当社子会社の
役員等に対し株式報酬として
新株予約権を発行する件

第4号議案 当社及び当社子会社の役員等に対し 株式報酬として新株予約権を発行する件

株式報酬（ストックオプション）の内容	
対象者	<p>当社執行役員、当社幹部社員、 子会社取締役、子会社執行役員、子会社幹部社員 ※対象者は86名</p>
新株予約権の総数	<p>新株予約権数 1,219個（上限） 当社普通株式 121,900株（上限）</p>
新株予約権の発行価額	無償
1株当たりの払込金額	1円
権利行使期間	<p>3年間の権利行使制限期間を設定、 行使期間は新株予約権の割当日から3年を経過する日の翌月1日から、 新株予約権の割当日から20年を経過する日の前月末日までとする</p>
行使条件	<p>① 新株予約権1個を最低行使単位とする ② その他の権利行使の条件は、お手元の招集ご通知をご参照ください</p>

第5号議案

当社取締役に対し
中期業績連動報酬として
株式報酬制度を導入する件

中期業績インセンティブプラン導入について

【中期業績インセンティブプラン導入の背景と目的】

- 未来に向けた新たな価値創出への挑戦が始まる
- 高度化かつ多様化する技術ニーズへ対応し、
中長期的な視点から早期に技術開発に取り組み、競合を上回る
- 企業の成長は人にあり、社員こそが価値創出の源泉
中長期の会社の取り組みとそのゴールを社員、経営陣が一体となって実現する

【対象】 国内外の当社グループ取締役、執行役員、幹部・中堅社員
このうち、当社取締役に対するプランに関して、本総会においてご承認をお願いするもの

【内容】 毎年期初作成の向こう3カ年の業績目標の達成度に応じて、株式を交付

第5号議案 当社取締役に対し中期業績連動報酬として 株式報酬制度を導入する件

当社取締役に対する中期業績連動株式報酬の内容

対象者	当社取締役（社外取締役を除く）
対象期間	連続する3事業年度
株式取得のため信託に拠出する 金銭上限額	4億8,000万円
交付等が行われる 株式等の数の上限	23,800株 ※
株式等の交付時期	対象期間終了後

※ 発行済株式総数に対する割合は約0.015%、
ただし、初年度に関して、信託は株式市場から当社株式を取得予定であるため希薄化は生じません。

当初対象期間（2018年4月～2021年3月）のプラン内容

当初対象期間（2018年4月～2021年3月）のプラン内容

業績達成指標

営業利益率 および ROEの 各3年平均値 に基づき
支給率 0%、50%～150%で変動

業績連動算定式

基準ポイント×1/2×営業利益率連動係数
+ 基準ポイント×1/2×ROE連動係数